

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มเพชร การประยุกต์ใช้งานฟิล์มเพชรเป็นโฟโตไ/doxideซึ่งมีโครงสร้างใหม่ p-diamond/i-Si/n⁺-Si, คุณสมบัติพื้นฐานของโฟโตไ/doxide ได้ออค และศึกษาการมีผลต่อรัตต่ำๆที่มีผลต่อโฟโตไ/doxideชนิดนี้ โดยฟิล์มเพชรชนิดพีที่มีความหนาตั้งแต่ 5-20 μm ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีซีวีดีแบบขดลวดความร้อนที่ความดันบรรยากาศบนแผ่นผลึกฐานรองซึ่งเป็นชิลิคอนชนิดพี(p⁻ : intrinsic) ระยะ(111) ที่มีสภาพด้านทันท่วง 2,000 Ω.cm หนาประมาณ 275 μm โดยใช้สารตั้งต้นเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีไบรอนไตรออกไซด์ผสมอยู่ สำหรับชั้นชิลิคอนชนิดอีน(n⁺) สร้างขึ้นด้วยการแพร่อะตอนฟอสฟอรัสเข้าไปทางด้านหลังของแผ่นผลึกฐานรองลึก 4 μm จากการทดลองพบว่าโครงสร้างดังกล่าวสามารถทำงานเป็นโฟโตไ/doxide ได้ออคได้ดี โดยมีกระแสเม็ดประมาณ 2.3 μA/mm², ศักยภาพในมีค่าอยู่ในช่วง 0.6-1.5 Volts, แรงดันพังทลายมีค่าสูงมากกว่า 100 Volts, ความจุไฟฟ้ามีค่าต่ำประมาณ 1.5-27.5 pF/mm² และให้กระแสแสงประมาณ 2-28 μA/mm² เมื่อถูกฉายด้วยแสงจากโอลจেนที่มีความเข้มแสง 650-9,500 lux ที่แรงดัน 0-10 Volts ความไวในการตอบสนองต่อสัญญาณแสงมีค่าความถี่คักutoff 320 kHz ที่ความด้านทันท่วงโหลด 1 kΩ (พื้นที่รับแสง 17.5 mm²) นอกจากนี้การทดลองยังได้แสดงให้เห็นถึงผลของอุณหภูมิ ผลของความหนาแน่นอะตอนสารเจือในฟิล์มเพชร ผลของความหนาของฟิล์มเพชร ผลของความหนาของชั้นอนิทรินซิก และผลของ漉漉ดายข้าวโลหะด้านรับแสง

ผลการศึกษาและวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้งานฟิล์มเพชรเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง และยังเป็นแนวทางของการพัฒนาประสิทธิภาพของโฟโตไ/doxide ชนิดนี้ต่อไป

ABSTRACT

This thesis presents the study on diamond films properties, application and basic properties of diamond thin films for the new structure of p-diamond/i-Si/n⁺-Si photodiode and study on parameters to effects on these photodiode. The 5-20 μm of p-diamond thin films thickness was synthesized on high resistivity of 2,000 Ω.cm p-type silicon(intrinsic) orientation of substrate (111), 275 μm. thickness by hot filament CVD technique at atmosphere pressure. Borontrioxide mixed with ethyl-alcohol was used for carbon source. n⁺-layer silicon was formed by thermal diffusion of phosphorous atoms from the back side of intrinsic silicon substrate. From the experimental results, it was found that this structure shows good basic properties of photodiode, which 2.3 μA/mm² of dark current, built-in voltage is about 0.6-1.5 Volts, more than 100 Volts breakdown voltage, capacitance is 1.5-27.5 pF/mm², photocurrent is 2-28 μA/mm² at 650-9,500 lux with reverse bias 0-10 volts and 320 kHz cut-off frequency with 1 kΩ load resistance (active area is 17.5 mm²). Furthermore, this experiment results perform the effects of temperature, carrier density, patterns of electrode, diamond thin films and intrinsic silicon layer thickness.

This experiments shows high potential of application of diamond thin films for opto-electronic devices and useful for the development of this photodiode.